

バックグラインドテープ

BACK GRINDING TAPE

■ 特長

- パーティクル発生が極めて少なく、洗浄工程が不要
- シリコンウエハとの密着性が良好で、BG 時の水回り対策に効果的
- 粘着力の経時変化が少なく、パーティクル発生を抑制
- 回路上の凹凸に追従し、研削精度出しに優れる

■ Feature

- Non-cleaning type.
- Non-porous.
- Constant adhesive strength during storage around 23°C.
- Fit to asperity of the circuit side.

■ 一般物性 Characteristic

品種 Item	基材 Base film	色相 Color	総厚 Thickness (μm)	粘着剤厚 Adhesion thickness (μm)	粘着力 Adhesive strength (N/20mm)	プローブタック Probe tack (N/20mm ²)	備考 Characteristics
BGE-122V	EVA	LB	140	20	1.5	1.4	標準タイプ (Standard type)
BGE-124S			160	40	1.3	1.3	バンブ付きウエハ研削用 (for bumped wafer)
BGE-164VC			205		2.4	2.9	
BGE-194U			235		2.5 (0.2)	4.0 (0.05)	UVタイプ (UV type)
P	PET	T	85	35	17.6	10.8	BGテープ剥がし用 (for peel BG tape)

* ()内は UV 照射後粘着力

* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

* 色相：MW(乳白)、LB(ライトブルー)、T(透明)

* UV 照射推奨条件：積算光量 150mJ 以上 /cm²。

* 被着体によって UV 照射条件は異なる場合があります。

* はく離フィルム (セパレータ) の厚さは含まれておりません。

* () is adhesive strength after UV.

* The above data are estimates, and not guaranteed.

* Color: MW (Milky White), LB (Light Blue), T (Transparent).

* UV irradiate condition: Light volume=above 150mJ/cm².

* But UV irradiate condition may change with dicing products.

* Separator thickness is not included.